

锦州神工半导体股份有限公司

关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算，公司 2023 年 1-6 月计提的各项减值损失总额约为 2,518.40 万元左右。具体情况如下表所示：

单位：人民币 万元

项目	2023 年半年度计提金额	备注
信用减值损失	313.53	应收账款、其他应收款
资产减值损失	2,204.87	存货跌价损失
合计	2,518.40	

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2023 年上半年，为保证足够的产品质量以满足客户认证需要和提高良品率，需要进行大量的工艺试验，导致部分产品库存增加。公司本着谨慎性原则，对 2023 年 6 月 30 日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价准备约 2,204.87 万元。

2. 坏账准备

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年半年度计提信用减值损失金额为 313.53 万元。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日